聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2018 年第四季自結財務報告

2019 年 2 月 14 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(14)日公告 2018 年第四季自結財務報告。

2018 年第四季財務概況

- 本季合併營收新台幣 42.14 億元，較前季增加 4%，較去年同期減少 24%
- 本季合併毛利率為 32.6%，較前季增加 7 個百分點；
  本季營業淨利率 18.7%，較前季增加 8.1 個百分點
- 本季營業淨利為新台幣 7.89 億元，較前季增加 84%，較去年同期減少 51%
- 本季稅後淨利為新台幣 7.33 億元，較前季增加 5%，較去年同期減少 45%；
  每股盈餘為新台幣 1.8 元，前季為新台幣 1.7 元

2019 年第一季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- 第一季營收可能較 2018 年第四季下滑 high-teens 百分比。
- 第一季可能因產能利用率下降之影響，毛利率預計約與 2018 年第三季相當。

管理者評論

"2018年下半年穩懋歷經了數個主要客戶進入庫存調整的階段，然而第四季營收在非手機相關應用的支撐之下略優於第三季，季成長約4%，也因為第四季產品組合較佳，營業毛利率回升到32.6%的水準。2018年全年營收達到新台幣173億元的新高，年成長1.4%，其中以3D感測相關營收年成長達4成水準為各項應用之最，全年毛利率則因折舊費用等固定成本的增加而成為31.3%。2018年第四季及全年EPS分別為新台幣1.8元及7.39元。

時序跨入2019年，對穩懋而言既是充滿期待的一年，也是充滿挑戰的一年。期待的是，5G世代即將到來，全球有機會在2019年目睹5G手機的推出，部份國家將局部開始體驗5G聯網，穩懋也有多個與5G手持式裝置及基礎建設相關的研發計畫及客戶認證正在進行中，為2019年開始之後的數年做準備，同時，在手持式裝置3D感測及光電元件上也有更多的技術發展及客戶在進行佈局中。挑戰的是，礙於各國5G時程不一，短期內基礎建設未到位，普遍認為2019年5G發展將處於非常初期的階段，普及率應該還很低；在新舊通信規格交替之際，短期間4G智慧型手機需求成長趨緩，加上國際間區域強權對抗衝擊全球經濟等，都為2019年的整體需求投下變數。所幸，穩懋不斷關注最新技術的走向，持續投入研發，積極參與客戶的開發計畫，得以見證許多未來供應鏈的發展，更加確定我們正走在一條正確的道路上，蓄積未來成長的能量。

展望2019年第一季，在傳統淡季加上終端需求不振的效應之下，營收預計將較2018年第四季下滑high-teens百分比，同時第一季可能因產能利用率下降之影響，毛利率預計約與2018年第三季相當。"

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中，穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。